

行业研究/动态点评

2019年03月22日

行业评级:

机械设备

增持 (维持)

**章诚** 执业证书编号: S0570515020001  
研究员 021-28972071  
zhangcheng@htsc.com

**肖群稀** 执业证书编号: S0570512070051  
研究员 0755-82492802  
xiaoqunxi@htsc.com

**李倩倩** 执业证书编号: S0570518090002  
研究员 liqianqian013682@htsc.com

**关东奇来** 021-28972081  
联系人 guandongqilai@htsc.com

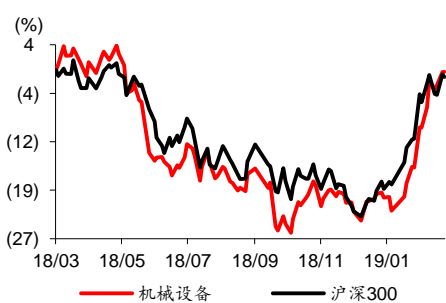
**黄波** 0755-82493570  
联系人 huangbo@htsc.com

**时或** 021-28972071  
联系人 shiyu013577@htsc.com

相关研究

- 1《机械设备: 浅谈机械行业估值方法及案例》2019.03
- 2《先导智能(300450,买入): 利润率改善, 新能源全球化率先受益》2019.03
- 3《徐工机械(000425,买入): 被低估的起重机行业龙头标的》2019.03

一年内行业走势图



资料来源: Wind

## 半导体设备国产化加快, 低端产能现过剩隐忧

### “芯”装备产业笔记之十八

#### 半导体设备本土龙头企业发展加快, 但出现行业分化和低端产能过剩隐忧

本周 SEMICON 展会 (共三天) 在上海举办, 我们连续拜访业界专家及上市公司, 整体感受是芯片国产化已经成为业界共识, 科创板推出为创业者拓宽了融资渠道。但是在“热闹”表现下, 也发现一些隐忧, 全球半导体设备行业份额高度集中于少数国际优势企业, 本土行业虽然才刚刚兴起、发展潜力较大, 但已经看到了技术壁垒相对较低的设备的产能过剩迹象。我们建议重点关注在各细分领域已建立一定竞争优势的国产设备企业, 包括: 北方华创、中微半导体设备 (未上市)、晶盛机电及本土测试设备龙头。

#### 全球设备市场正处于增速换挡期, 5G+AI+IoT 有望催生产业新一轮成长

我们认为 2018-19 年或是全球半导体设备需求调整期, 未来应用市场新旧动能或发生转换, 传统 PC 和智能手机市场增长趋缓, 5G、物联网 (IoT)、汽车电子、人工智能 (AI) 等新兴应用成为市场增长重要动力。需求回升将推动设备进入新一轮增长期, SEMI 预计 2019 年全球设备市场或小幅下滑 3% 至 600 亿美元, 2020 年增速将达 20%, 中国大陆将是主要增长极。

#### 加快芯片国产化已成业界共识, 科创板更让创业者看到新的政策支持力度

对比一年前的展会, 今年可以感受到业界对于芯片国产化的重视和共识, 这也是推动设备国产化率上升的逻辑基础。此外, 今年业界谈论较多的还有对科创板的关注和期待, 希望科创板的推出能够为国内产业链内企业的发展和壮大提供更多外部融资、技术整合的渠道和支持。

#### 但从展会“热闹”景象下, 也看到一些相对低技术门槛设备产能过剩迹象

今年展会出现了若干“跨界而来”的半导体设备公司, 这一现象引起了我们对于未来潜在的设备产能过剩的担忧, 核心原因是我们认为真正具备国产化能力的本土半导体设备企业并不多, 因为符合工艺标准的产品要靠长期技术经验积累而非靠并购和“跨界”。能够抓住国产化率提升机遇的本土设备企业一般都需要具备系统集成、技术专利及研发投入、核心部件供应商体系等多方面的要素和能力。更关键的是获得客户企业的认可, 这种认可来自于设备的产出效率、稳定性和性价比, 单纯以相对较低的售价来竞争不符合商业逻辑, 对客户企业来说价值也不大。

#### 本轮国产化是值得重视的投资机会, 关注各领域排名前二的本土设备企业

半导体设备可以分为硅片制造、晶圆制造、封装测试设备。我们认为按照产业链先后道顺序, 竞争格局相对好的细分行业包括硅片生长炉及切磨抛设备、刻蚀和沉积设备、高性能检测及缺陷扫描设备等。但目前国产设备市场份额总体较低, 竞争压力不容小觑, 以晶圆刻蚀设备为例, 据 The Information Network 数据, 2017 年全球市场份额分布为泛林 55%、应用材料 19%、东京电子 20%, 日立、中微 (AMEC)、北方华创 (NAURA) 等合计 6%。我们建议关注各细分行业已取得进步的本土设备龙头, 设备国产化率提升的趋势将带来投资机会。

风险提示: 国内半导体制造技术突破慢于预期、投资不及预期; 国内晶圆厂建设进程不及预期; 本土半导体设备企业技术突破不及预期。

## 免责声明

本报告仅供华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的资产管理部、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J。

全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：A0K809

©版权所有 2019 年华泰证券股份有限公司

## 评级说明

### 行业评级体系

一报告发布日后的6个月内的行业涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅为基准；

一投资建议的评级标准

增持行业股票指数超越基准

中性行业股票指数基本与基准持平

减持行业股票指数明显弱于基准

### 公司评级体系

一报告发布日后的6个月内的公司涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅为基准；

一投资建议的评级标准

买入股价超越基准20%以上

增持股价超越基准5%-20%

中性股价相对基准波动在-5%~5%之间

减持股价弱于基准5%-20%

卖出股价弱于基准20%以上

## 华泰证券研究

### 南京

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

### 深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

### 北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层  
 邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

### 上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com